

性能特点：

- 频带：0.8-2GHz
- 增益：28dB
- 饱和输出功率：29dBm
- 功率附加效率：40%
- 电源供电：+8V@235mA
- 芯片尺寸：3.2mm×2.0mm×0.1mm

产品简介：

HH-DA00802 是一款 GaAs MMIC 驱动放大器芯片，其频率范围覆盖 0.8~2.0GHz，整个频带内输出饱和功率为 29dBm，功率附加效率大于 40%。

电参数： ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_d=+8\text{V}$, $V_G=-0.7\text{V}$)

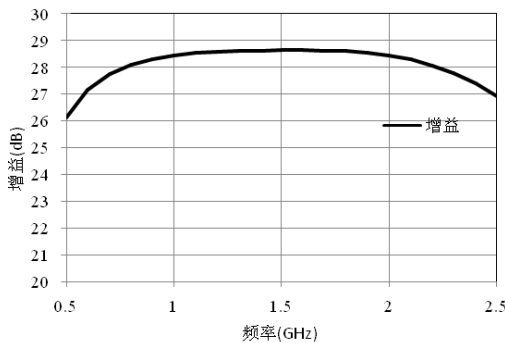
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	0.8-2			GHz
增益	-	28	-	dB
饱和输出功率	-	29	-	dBm
输入回波损耗	-	25	-	dB
输出回波损耗	-	14	-	dB

使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

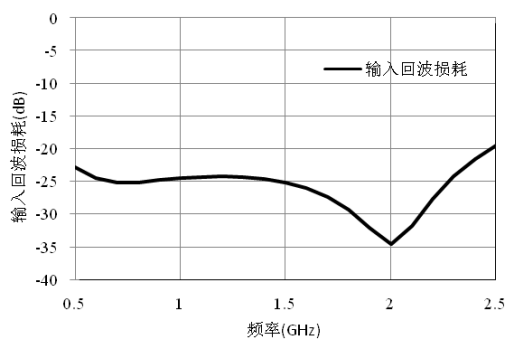
输入功率	+12dBm
电压	+9V
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~85°C

典型曲线：

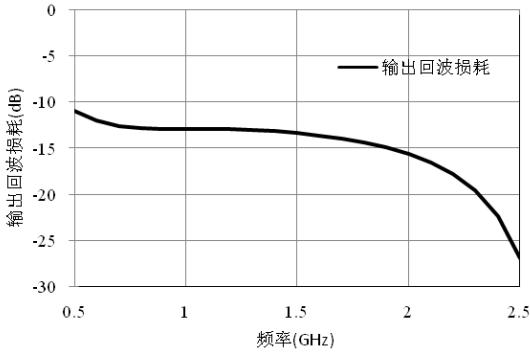
增益 Vs 频率



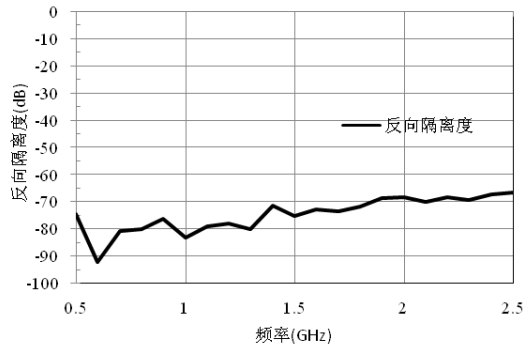
输入回波损耗 Vs 频率



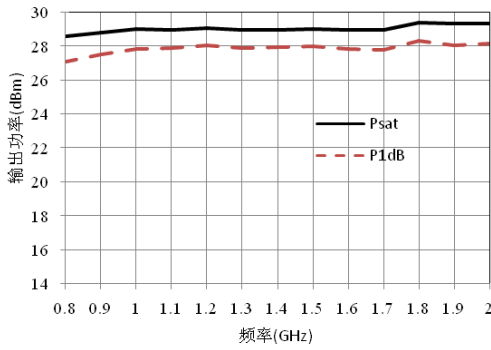
输出回波损耗 Vs 频率



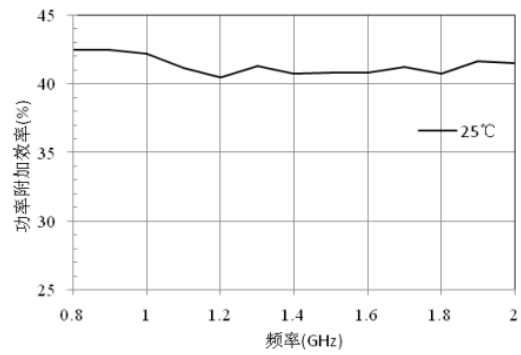
反向隔离度 Vs 频率



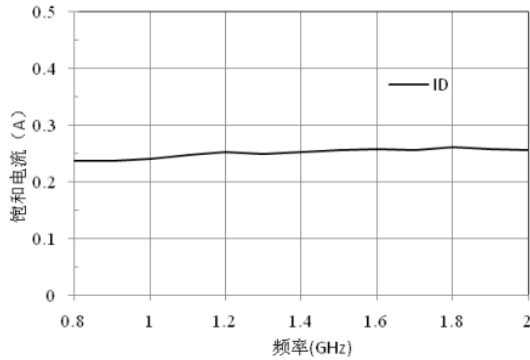
输出功率 Vs 频率



功率附加效率 Vs 频率



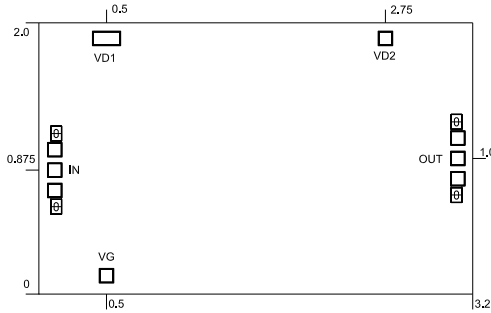
饱和电流 Vs 频率



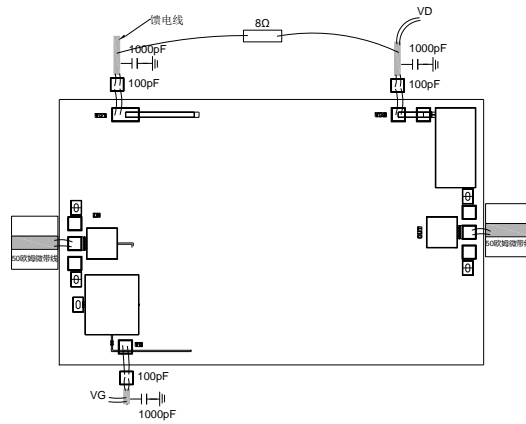
尺寸图：(单位 mm)

02

驱动 / 功率放大器



建议装配图：



使用说明：

注意事项：输入输出有隔直电容

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根 (建议直径 25um 金丝) 键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装 (或基板)。